

主な半導体製造装置の世界シェア(2018年)

装置	内容	メーカー	シェア (%)
露光装置	光を照射して半導体基板に回路パターンを焼き付ける半導体製造の中核工程	ASML(オランダ)	88.5
		ニコン	7.2
		キヤノン	4.3
コータ・デベロッパ ー	コータは基板に回路を形成する感光剤を塗布、デベロッパーは露光した感光剤を現像	東京エレクトロン	91.2
		SCREENホールディングス	4.6
		シーメンス(独)	2.4
エッチング 装置	半導体基板に超精密な凹凸を形成。高集積化にはガスを使って加工するドライエッチング装置が必須	ラムリサーチ(米国)	47.3
		東京エレクトロン	19.2
		アプライドマテリアルズ(米国)	19.2
		日立ハイテク	5.6
CVD装置	薄膜形成装置の一つで、半導体基板の表面に、10 ² ナノメートルから1000 ² ナノメートル程度の薄い膜を堆積	アプライドマテリアルズ	35.8
		ラムリサーチ	31.0
		ASM(オランダ)	11.6
		東京エレクトロン	10.9
欠陥検査	半導体製造の各工程上で半導体基板や半導体チップに、何らかの欠陥が生じていないかを検査	KLAテンコール(米国)	72.5
		アプライドマテリアルズ	17.8
		漢微測科技[エルメス・マイクロビジョン](台湾)	9.0
		日立ハイテク	0.8

(注) 漢微測科技は2016年にASMLが買収しており、資本はオランダ系

(出所) 野村証券の資料を基にアーキテクトグランドデザイン作成